

天水华天科技股份有限公司封装压焊图 Tianshui Huatian Technology Co.,Ltd Bonding Diagram										DWB 模板图号		M-LFCL0641313C	
封装形式 PKG Type:		载体规格 Lead Frame Size:		客户代码 Customer		客户系列 Customer Series		压焊图号 BD No:		压焊图号条码区			
LQFP64L(0707×1.4)		130X130 (C) (mil <sup>2</sup> )		BB52				YBB52LQF064006					
电压值 Voltage Value:													
产品型号 Part NO:		SMD132											
		芯片A DIE A:		芯片B DIE B:		芯片C DIE C:							
芯片型号 Die Type:		AA6023A											
光罩号 Mask #:													
芯片尺寸 Die Size:		1840X1310 (um <sup>2</sup> )											
焊点尺寸 Pad Size:		80X80 (um <sup>2</sup> )											
粘片胶 D/A:		导电胶											
焊点最小间距 Min Pad Pitch													
焊点结构 Pad Structure		Via设计											
铝垫成份 Pad Composition		Al、Si、Cu											
铝层厚度 Aluminum Layer Thickness		0.8um											
是否为MOS:		□是 ■否		□是 □否		□是 □否							
粘片顺序:													
点(画)胶 示意图:													
上芯胶量 控制要求:													
焊点下有器件的焊点是:		无											
其它要求:													
<p>请确认此图转换内容是否正确?若无误,请尽快签字回传。</p> <p>2015. 11. 17</p> <p>焊线数:56根</p>													
绘图单位:		um		绘图比例:		1:1							
Rev. A		新建立		2015. 04. 21									
版本 Rev.		变更历程 Change History		日期 Date									
拟制 Converted by		上芯工程审核1 Approved by 1		压焊工程审核2 Audited by 2		塑封工程审核3 Approved by 3		技术部审核4 Approved by4		批准 Approved by		用户确认 Customer Confirm	
压焊图特征码		多芯片		叠层多芯片		MOS		焊点下有器件		绝缘胶		DAF	
金线		载体焊线		裂纹风险		铜线		银合金线					
是:1 / 否:0		■0 □1		■0 □1		■0 □1		■0 □1		■0 □1		00 □1 ■1 ■0 □1	
00000000010												特征码条码区	

BOM表				
压焊图号 (BD No):		YBB52LQF064006		
BOM号 (BOM No):		BBB52LQF064006		
材料 (Material)		型号 (Model)		备注 (Remark)
框架 (Lead Frame Size)		130X130 (C) (mil <sup>2</sup> )		芯片名称 (Die Name)
粘片材料 (D/A) (A芯片)		二选一 (Alternative)		AA6023A
		首选 (Preferred): S502 备选 (Optional):		
粘片材料 (D/A) (B芯片)		二选一 (Alternative)		1840X1310 (μ m <sup>2</sup> )
		首选 (Preferred): 备选 (Optional):		
粘片材料 (D/A) (C芯片)		二选一 (Alternative)		
		首选 (Preferred): 备选 (Optional):		
塑粉料 (M/C)		二选一 (Alternative)		签名 (Signature):
		首选 (Preferred): CEL-9220HF10TS (LS) 备选 (Optional):		
线径 (Wire Dia)		Ø=25um Cu		日期 (Date):